

证券代码：688598

证券简称：金博股份

湖南金博碳素股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	财通证券、中庚基金、东吴证券、民生证券、国寿安保基金、华福证券、国泰君安证券、中信证券、西南证券、华创证券、睿远基金、长江证券、华夏基金、国富基金 (排名不分前后)
时间	2024年8月5日-9月20日
地点	现场、线上会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司光伏热场板块毛利率同比下降，是否能保持技术领先性？</p> <p>目前光伏产业链的竞争进一步加剧，落后产能出清速率加快。受下游硅片去库存，硅片开工率大幅调整等因素影响，公司采取了更加稳健的经营策略，在客户体系方面做了进一步优化，防范产业周期带来的经营性风险。另一方面公司通过技术优化和协同创新，持续降低碳基复合材料生产成本，同时保持对产品研发的投入，不断推进碳基材料系列产品技术迭代和应用，全面提升公司碳基材料产品在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域</p>

的研发创新能力，不断提高公司技术和研发水平的领先性，持续保持公司在光伏热场材料细分领域的领先地位。

二、公司半导体热场产品下游验证情况？是否已应用第三代半导体衬底企业？

公司持续开展技术攻关，开发的超高纯保温材料新产品，已应用于硅基半导体和碳化硅半导体生长等高温热场系统；开发的高性能碳化钽涂层及其制备技术，可满足碳/碳复合材料、石墨等不同碳基材料基底的抗腐蚀涂层制备需求，可广泛应用于单晶硅、碳化硅等高纯晶体制造热场系统。

三、公司碳/陶制动盘目前进展如何，目前新能源汽车碳/陶制车盘的渗透率极低，公司应对措施？

公司已初步建立完整的碳/陶制动盘产品体系，具备为下游主机厂各类车型开发碳/陶制动盘及摩擦副系统解决方案的产业化能力。公司碳/陶制动盘产品从车型定点到定点车型上市发售需要一定的时间周期，具体发售时间与主机厂定点车型的整体推进进度有关，碳/陶制动盘在新能源汽车制动领域中的市场渗透率随着公司碳/陶制动盘产品定点车型的陆续发售将逐步提升。

四、公司锂电热场市场拓展进度如何？毛利率如何提升？

公司已成功研发和量产碳/碳匣钵、坩埚、箱板、立柱等锂电池正/负极材料制备用碳基复合材料高温热场产品，并已应用于公司锂电负极一体化示范线 I 期 5 万吨项目，可为客户提供锂电碳基复合材料热场系列产品及代工服务整体解决方案。公司开发的锂电碳基复合材料热场系列产品在提高石墨化装载量的同时，其使用寿命、强度、纯度等各项性能均达到行业先进水平，可有效降低客户的制备成本，进一步加快实现锂电池热场从石墨材料到碳基复合材料的升级换代。公司锂电碳基复合材料热场系列产品目前在下游客户验证拓展情况顺利，已向国内多家重点锂电正/负

	<p>极材料厂商正式供货，另有多家锂电负极材料客户正在产品验证中。目前锂电负极行业产能结构性过剩，公司将继续通过技术创新、工艺优化、精细管理等方式推进降本增效工作，不断提高锂电业务毛利率水平。</p> <p>五、公司碳纸目前销售情况如何？未来市场空间初步测算有多大？</p> <p>公司已完成片状碳纸小批量供货，高性能卷对卷气体扩散层产线已开始试生产，产品已导入国内头部气体扩散层、膜电极、电堆企业供应链体系。根据高工氢电数据，氢燃料电池车市场对气体扩散层的需求有望在 2025 年达到 100 万平方米，基体单元碳纸的市场需求将逐步释放。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 26 日